

上海润欣科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、2024 年度公司经营情况

公司自成立以来一直专注于无线通信 IC、射频 IC 和传感器器件的分销、应用设计及技术创新，是国内领先的 IC 产品和 IC 解决方案提供商。目前公司主要的 IC 供应商有高通、安世半导体、恒玄科技、瑞声科技、思佳讯、AVX/京瓷等，拥有美的集团、大疆创新、小米科技等客户，是 IC 产业链中连接上下游的重要纽带。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

报告期内，公司在 AIoT 智能模组、汽车电子、音频传感器等领域的业务发展稳健。2024 年度公司营业收入 25.96 亿元，比 2023 年度增长 20.16%；2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润 3,636.98 万元，比 2023 年度增长 2.07%；2024 年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,450.26 万元，比 2023 年度增长 10.17%；2024 年度、2023 年度公司经审计合并利润表中归属于上市公司股东的剔除股权激励计划实施所产生的股份支付费用影响后的净利润分别为 5,081.28 万元、3,225.36 万元，2024 年度比 2023 年度增长 57.54%。

AI+边缘计算与传感器异构集成等创新技术带来新的机会

2023 年爆发的 AGI 对 CPU、GPU、AI 专用芯片提出了更高的硬件算力和数据带宽需求。在芯片设计时不仅仅要考虑多制程多节点的架构，还需要结合工艺、能效比、功能模块互联，才能满足各种多样的客户需求。报告期内，为增强公司 AIoT 芯片业务的边缘计算能力，提升公司在声学 and 可穿戴传感领域的关键技术水平，公司参股国家智能传感器创新中心，启动感存算一体化产业生态建设，双方规划通过 PZT 薄膜化 MEMS 生产工艺平台、PMUT 感存算一体化芯片项目，充分发挥国家智能传感器创新中心在 MEMS 传感器特色工艺、先进封测领域的技术优势和产业地位，在智能声学、智能家居和生物检测等领域开展 IC 定制设计和产业合作。

新的工艺平台旨在打造国内稀缺的 PZT 压电薄膜传感器量产线，广泛应用于自动对焦芯片、换能器、超声感应、激光雷达微镜等多个领域。随着 AI 应用的场景落地，全球已开发出上千种各类智能传感器，从分离感知，到结合视觉、声音、毫米波等多种传感算法的 FSD 系统，再到未来的具身智能（机器人）行业，推理计算、存储和传感算法三者融合，将成为公司未来新的业务增长点。

报告期内，公司利用多年来在 AIoT、传感领域的技术和客户积累，与上游半导体设计公司合作，为重点客户定制无线智能家电芯片 Holacon WB01-L、AI 眼镜 SOC 芯片及组件。公司自研设计的温度传感器控制和显示芯片 XN3660、智能视觉 LED 驱动芯片 XM9823、XM887X 等已形成规模销售。近年来，随着 AI、新能源汽车等新兴市场的崛起，集成电路设计需要融合无线通讯、传感器、存储、计算等多种功能模块，应用于各行各业的智能化场景落地，形成商业闭环。2024 年，公司“定制和自研芯片”业务共实现销售额 1.76 亿元人民币，同比增长 42.22%，公司的芯片研发和集成设计能力得到了明显的提升。

报告期内，公司与奇异摩尔（上海）集成电路设计有限公司在 Chiplet 互联产品和 AI 算力芯片等领域开展合作，提供包含 ASIC 定制、算法设计、芯片交付与行业集成在内的一系列服务。公司产品规划采用 Chiplet 异构堆叠工艺，通过把 SOC 芯片分成面积更小的芯粒，根据客户需求把内存、MEMS 传感器、无线处理芯片等小芯粒异构集成在一起，体现出高良率、低成本和快速交付的 IC 工艺优点。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

2024 年度，公司董事会共召开了七次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议议案
1	第四届董事会第十七次会议	2024 年 4 月 25 日	(1) 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 (2) 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 (3) 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 (4) 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 (5) 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 (6) 《关于 2024 年中期利润分配安排的议案》

			(7) 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 (8) 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 (9) 《关于 2023 年度审计报告的议案》 (10) 《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告的议案》 (11) 《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告的议案》 (12) 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 (13) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 (14) 《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》 (15) 《关于会计政策变更的议案》 (16) 《关于香港子公司记账本位币变更的议案》 (17) 《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》 (18) 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 (19) 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》 (20) 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 (21) 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 (22) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 (23) 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格的议案》 (24) 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就的议案》 (25) 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 (26) 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 (27) 《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》 (28) 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 (29) 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 (30) 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 (31) 《关于 2024 年第一季度计提资产减值准备及核销坏账的议案》 (32) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 (33) 《关于召开 2023 年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》
2	第四届董事会第十八次会议	2024 年 5 月 16 日	(1) 《关于对外投资暨关联交易的议案》
3	第五届董事会第一次会议	2024 年 6 月 7 日	(1) 《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》 (2) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 (3) 《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》

			(4) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
4	第五届董事会第二次会议	2024年7月19日	(1) 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 (2) 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 (3) 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》 (4) 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
5	第五届董事会第三次会议	2024年8月12日	(1) 《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 (2) 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
6	第五届董事会第四次会议	2024年8月28日	(1) 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 (2) 《关于<2024年中期利润分配方案>的议案》 (3) 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 (4) 《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》 (5) 《关于对外投资签署补充协议暨关联交易的议案》 (6) 《关于修订公司<外汇套期保值管理制度> <募集资金管理制度>的议案》
7	第五届董事会第五次会议	2024年10月23日	(1) 《关于<2024年第三季度报告>的议案》 (2) 《关于2024年前三季度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

本年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

三、公司未来发展的展望

在全球半导体产业加速向地域化、AI+智能化演进的背景下，公司将以“AI驱动、数字生态共建、供应链安全”为核心战略，聚焦芯片算力升级、应用场景创新和供应链资源协同，夯实未来三至五年的可持续发展基础。

1、积极投入“端-云协同”技术研发，打造“边缘智能体”生态

基于公司在低功耗无线连接芯片、智能穿戴SOC芯片及多模态传感器技术（视觉/听觉/环境感知）的领先优势，依托谷歌、字节、阿里等云平台设计智能模块和软件工具，利用无线芯片的空口优化，使智能终端设备可直接参与模型训

练和推理。据 ABI Research 预测，2027 年全球 AIoT 边缘智能芯片市场规模将达 290 亿美元，这意味着几乎所有网络产品都会被重做一遍。AIGC 的跨越式升级，给每一款智能硬件带来嵌入模型和边缘算力，并具备与人用视觉与自然语言进行交互的能力。根据格兰研究和 Strategy Analytics 公布的数据，全球数十亿台的路由器、机顶盒、音响、门禁摄像头都有智能化升级的需求，客厅智能硬件将成为除 PC 和手机以外的第三大智能硬件市场，国际各大科技公司都开始推出基于流媒体和 AI 语音交互的 Home Station，作为智能家居的重要入口之一。

公司规划集成边缘计算芯片，采用 NPU+ISP+无线基带的 SOC 芯片，支持客厅智能硬件、AI 穿戴终端、安防摄像头等终端的本地化 AI 推理，组合芯片+算法+开发套件平台，聚焦数字城市、智能家居和智慧养老市场的数字化场景。报告期内公司与主要供应商合作，采用低功耗 AI 芯片实施机器学习，扩充 AI 语音交互和视觉功能。产品通过智能化的 Home Station、AI 穿戴设备，为老年人群提供个性化的情感交流和提醒服务。AGI 带来的海量算力需求，使得端侧的边缘计算能力成为传统云计算的极大补充，边缘计算靠近数据源头，可以就近提供智能服务，满足数字城市、智能家居场景在敏捷连接、实时响应、传感数据采集、安全与隐私保护等方面的需求。

2、固守传统成熟工艺产品，平衡区域关税和汇率风险

中国大陆是世界 4C 产品的生产基地，在全球半导体行业流通的三万余种 IC 产品中，只有少数的高端芯片如 CPU、GPU、NPU 必须采用最先进的制程和昂贵的设备，而更多的 IC 产品则应该使用成熟工艺、特色工艺和低成本设备制造，才能具有市场竞争力。行业预测到 2030 年，全球半导体行业的销售额将超过 1.2 万亿美元，其中增长最为快速的市场包括了 AI+终端、汽车电子、服务器云计算中心等。以 AI+终端为例，海量的数据在物理传感、模数转换、信号存储、逻辑计算和控制芯片之间流转，这些应用芯片中的大多数都只需用到 40nm、55nm 以上的成熟工艺，无需先进工艺，成本低廉，在芯片 IP、EDA、半导体材料等方面可以免除西方的技术禁售限制。

为顺应市场变化，公司规划增加传感器芯片、分立器件、算力存储芯片等在公司业务中的占比，增加晶圆代工分销服务和模数混合芯片设计业务，整合中国大陆和台湾带有特色工艺的晶圆代工厂产能，提供包括 EDA 综合工具、晶圆 CP

测试、传感器封测、芯片定制设计在内的系列服务,保障在优势领域的无线芯片、信号调理芯片和 MEMS 传感器的本地供应。此外, 公司规划构建“本地研发+区域性市场枢纽+友岸仓储制造”的供应链架构, 平衡地缘关税与汇率风险, 提升公司主营业务的核心竞争力。

润欣科技的核心优势是专注、专业化, 公司有信心在未来继续维持良性的增长, 公司将秉承“专注、专业化、差异化”的理念, 为客户创造价值, 为员工提供稳定开放的工作环境, 为股东和社会创造效益。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日